

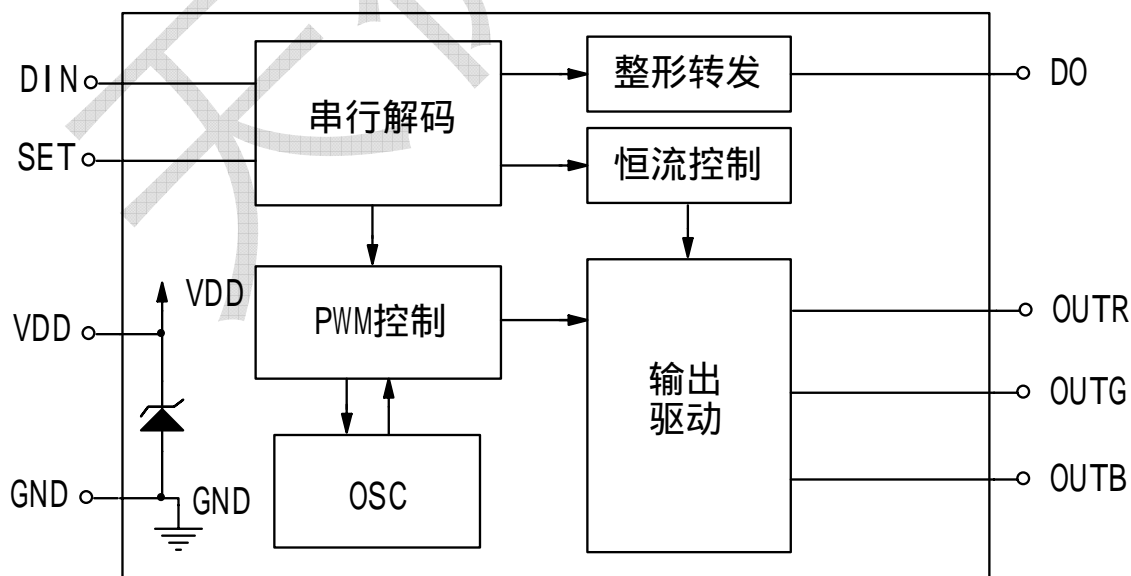
## 特性描述

TM1829是三通道LED（发光二极管）恒流驱动控制专用电路，内部集成有MCU单线数字接口、数据锁存器、LED恒流驱动等电路，PWM辉度控制电路。芯片可通过单线数字接口（DI、DO）级联，外部控制器只需单线就可控制该芯片和与其级联的后续芯片。TM1829输出端口的恒流值与PWM辉度都可单独通过外围控制器设置。VDD引脚内部集成5V稳压管，外围器件少。本产品性能优良、质量可靠。

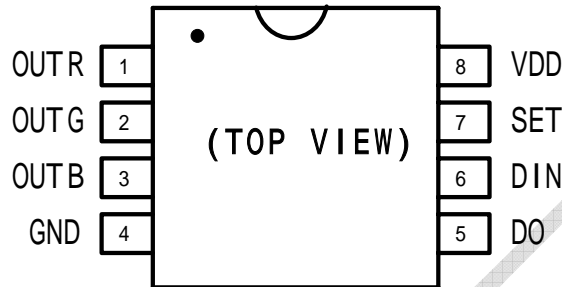
## 功能特点

- 采用功率CMOS工艺
- OUT输出端口耐压24V
- VDD内置5V稳压管，串接电阻后电压支持6~24V
- 辉度调节电路，256级辉度可调
- 单线串行级联接口
- 振荡方式：内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步，在接收完本单元的数据后能自动将后续数据再生后通过数据输出端发送至下级，信号不随级联变远而出现失真或衰减
- 内置上电复位电路
- PWM控制端能够实现256级调节，扫描频率7KHZ
- 恒流电流能够实现32级调节（10mA—41mA）
- 能通过一根信号线完成数据的接收与解码
- 当刷新速率为30帧/s时，级联数低速模式下不小于1024点，高速模式下不小于2048点
- 数据传输速率可达800Kbps与1.6Mbps两种模式
- 任意两点传输距离不少于30米
- 封装形式：SOP8、DIP8

## 内部结构框图



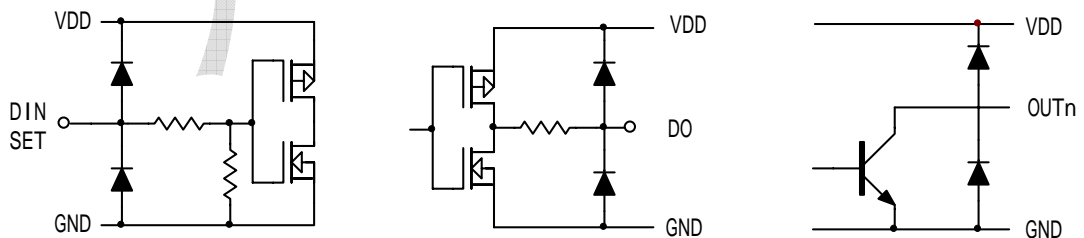
管脚排列



管脚功能

| 引脚名称 | 引脚序号 | I/O | 功能说明                       |
|------|------|-----|----------------------------|
| DIN  | 6    | I   | 数据输入                       |
| DO   | 5    | O   | 数据输出                       |
| SET  | 7    | I   | 接VDD：高速模式；<br>接GND或悬空：低速模式 |
| OUTR | 1    | O   | Red PWM恒流输出                |
| OUTG | 2    | O   | Green PWM恒流输出              |
| OUTB | 3    | O   | Blue PWM恒流输出               |
| VDD  | 8    | -   | 逻辑电源                       |
| GND  | 4    | -   | 接系统地                       |

输入输出等效电路





集成电路系静电敏感器件，在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电，静电放电可能会损坏集成电路，天微电子建议采取一切适当的集成电路预防处理措施，不正当的操作和焊接，可能会造成 ESD 损坏或者性能下降，芯片无法正常工作。

**极限参数<sup>(1)(2)</sup>**

| 参数名称       |                  | 参数符号             | 极限值            | 单位  |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 逻辑电源电压     |                  | VDD              | -0.5 ~ +7.0    | V   |
| 输入端电压范围    | DIN, SET         | V <sub>in</sub>  | -0.5 ~ VDD+0.7 | V   |
| 输出端电流 (DC) | OUTR, OUTG, OUTB | I <sub>out</sub> | 41             | mA  |
| 输出端电压范围    | OUTR, OUTG, OUTB | V <sub>out</sub> | -0.5 ~ +30.0   | V   |
| 时钟频率       | DIN              | F <sub>clk</sub> | 2.0            | MHZ |
| 工作温度范围     |                  | T <sub>opr</sub> | -40 ~ +85      |     |
| 储存温度范围     |                  | T <sub>stg</sub> | -55 ~ +150     |     |
| 人体模式 (HBM) |                  | ESD              | 4000           | V   |
| 机器模式 (MM)  |                  |                  | 400            | V   |

(1) 芯片长时间工作在上述极限参数条件下，可能造成器件可靠性降低或永久性损坏，天微电子不建议实际使用时任何一项参数达到或超过这些极限值；

(2) 所有电压值均相对于系统地测试。

**推荐工作条件**

| 在 -45 ~ +85 下测试，除非另有说明 |                  |              | TM1829 |     |         | 单位 |
|------------------------|------------------|--------------|--------|-----|---------|----|
| 参数名称                   | 参数符号             | 测试条件         | 最小值    | 典型值 | 最大值     |    |
| 电源电压                   | VDD              |              | 4.5    | 5.0 | 5.5     | V  |
| DIN 输入耐压范围             | V <sub>din</sub> | DIN 串接 1k 电阻 | -0.5   | --  | VDD+0.7 | V  |
| SET 输入耐压范围             | V <sub>set</sub> | SET 串接 1K 电阻 | -0.5   | --  | VDD+0.7 | V  |
| DO 输出耐压范围              | V <sub>do</sub>  | DO 串接 1K 电阻  | -0.5   | --  | VDD+0.7 | V  |
| OUT 输出耐压范围             | V <sub>out</sub> | OUT = OFF    | -0.5   | --  | 24.0    | V  |
| 工作温度范围                 | T <sub>a</sub>   |              | -40    |     | +85     |    |
| 工作结温范围                 | T <sub>j</sub>   |              | -40    |     | +125    |    |

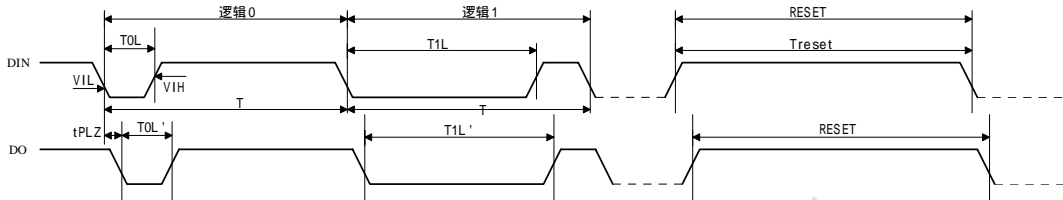
## 电气特性

| (在 VDD=5.0V 和 -40 ~+85 下, 典型值 VDD=5.0V 和 TA=+25 ) 除非另有说明 |          |                                    | TM1829  |      |         | 单位  |
|--|----------|------------------------------------|---------|------|---------|-----|
| 参数名称   | 参数符号     | 测试条件                               | 最小值     | 典型值  | 最大值     |     |
| 高电平输出电压  | Voh      | Ioh=-6mA : DO                      | VDD-0.5 | VDD  | VDD+0.5 | V   |
| 低电平输出电压  | Vol      | Iol=10mA : DO                      |         |      | 0.4     | V   |
| 高电平输入电压  | Vih      | VDD=5.0V                           | 3.5     |      | VDD     | V   |
| 低电平输入电压  | Vil      | VDD=5.0V                           | 0       |      | 1.35    | V   |
| 高电平输出电流  | Ioh      | VDD=5.0V, SDO=5.0V                 |         | 1    |         | mA  |
| 低电平输出电流  | Iol      | VDD=5.0V, SDO=1.0V                 |         | 10   |         | mA  |
| 输入电流   | Iin      | DIN 接 VDD 或 GND                    | -1      |      | 1       | μ   |
| 逻辑电源电流 (VDD)   | Icco     | OUTR, OUTG, OUTB, DIN, SET, DO=开路  | 1.2     | 3.0  | 4.2     | mA  |
| 恒定输出电流范围   | Iolc     | OUTR, OUTG, OUTB= 3.0V             | 10      |      | 41      | mA  |
| 输出漏电流  | Iolck    | OUTR, OUTG, OUTB =OFF              | 0       |      | 0.3     | μA  |
| OUT 端口占空比周期  | Tpwm     | OUT 接上拉电阻                          | 135     | 140  | 145     | μs  |
| 恒流误差 (通道对通道)   | Iolco    | OUTR, OUTG, OUTB =ON, VOUTn =1V    |         |      | ±3      | %   |
| 恒流误差 (芯片对芯片)   | Iolc1    | OUTR, OUTG, OUTB =ON, VOUTn =1V    |         |      | ±6      | %   |
| 线性调整   | Iolc2    | OUTR, OUTG, OUTB =ON, VOUTn =1V    |         | ±0.5 | ±1      | %/V |
| 负载调整   | Iolc3    | OUTR, OUTG, OUTB =ON, VOUTn =1V~3V |         | ±1   | ±3      | %/V |
| 动态电流损耗   | Idddyn   | OUTR, OUTG, OUTB =OFF, DO=开路       |         |      | 3       | mA  |
| 热阻值  | Rth(j-a) |                                    | 79.2    |      | 190     | /W  |
| 消耗功率   | PD       | (Ta=25 °C)                         |         |      | 250     | mW  |

## 开关特性

| (在 VDD=5.0V 和 -40 ~+85 下, 典型值 VDD=5.0V 和 TA=+25 ) 除非另有说明 |       |                            | TM1829 |     |     | 单位  |
|--|-------|----------------------------|--------|-----|-----|-----|
| 参数名称   | 参数符号  | 测试条件                       | 最小值    | 典型值 | 最大值 |     |
| 低速模式   | fosc1 | DIN 悬空或接 GND               |        | 800 |     | KHz |
| 高速模式   | fosc2 | DIN 接 VDD                  |        | 1.6 |     | MHz |
| OUT PWM 输出频率   | Fout  | OUTR, OUTG, OUTB           | 6.5    | 7   | 7.5 | KHz |
| 传输延迟时间   | Tplz  | DIN DOUT                   |        |     | 200 | ns  |
|  |       | CL = 15pF, RL = 10K        |        |     | 100 | ns  |
| 下降时间   | Tthz  | CL = 300pF, OUTR/OUTG/OUTB |        |     | 80  | μs  |
| 输入电容   | CI    |                            |        |     | 15  | pF  |

**时序特性**



**功能说明**

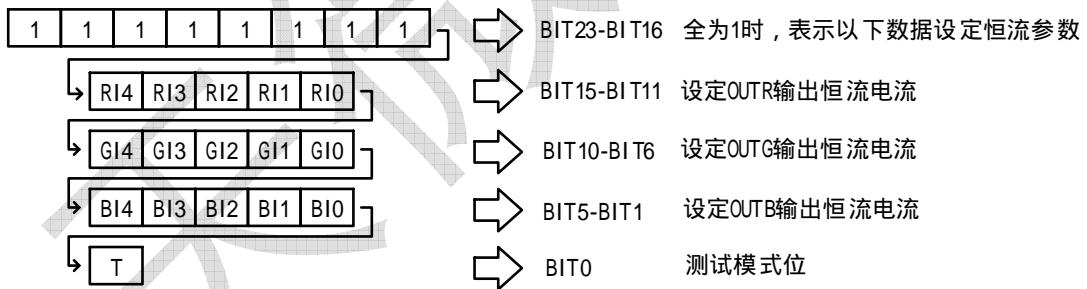
本芯片采用单线通讯方式，采用归零码的方式发送信号。芯片在上电复位以后，接受DIN端送来的数据，接收完24bit后，DO端口开始转发DIN端继续发来的数据，为下个级联芯片提供输入数据。在转发数据之前，DO口一直为高电平。如果DIN输入RESET复位信号，芯片将在复位成功后根据接收到的24bit数据输出相对应PWM占空比波形，且芯片重新等待接受新的数据，在接收完开始的24bit数据后，通过DO口转发数据，芯片在没有接受到RESET信号前，OUTR、OUTG、OUTB管脚原输出保持不变。

芯片采用自动整形转发技术，信号不会失真衰减，使得该芯片的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限刷屏速度要求。

**1、数据结构**

恒流模式命令：

芯片上电复位后，DIN输入的数据为每连续24bit为一个完整数据包，先发高位，如果高8位[bit23-bit16]全为1，则该数据包是恒流设定数据，其结构如下：



RI [bit15~bit11]: 设定R通道恒流值， $I_r = 10 + RI[4:0] \text{mA}$ ，即最小 $10 + 0 = 10\text{mA}$ ，最大 $10 + 31 = 41\text{mA}$

GI [bit10~bit6]: 设定G通道恒流值，设定方式同上

BI [bit5~bit1]: 设定B通道恒流值，设定方式同上

T: 测试模式位。 1: 此位置位时，测试模式

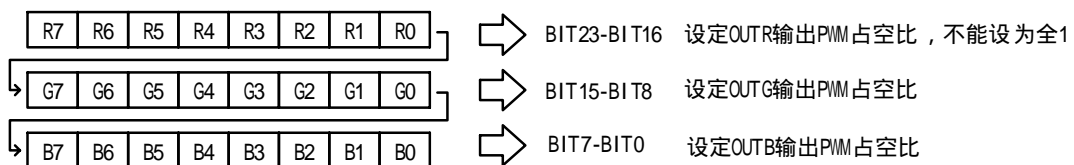
0: 此位清零时，正常工作模式，OUT输出PWM

[bit15~bit11]位为分别独立设定OUTR，OUTG，OUTB引脚输出恒流值，数值范围从0~31，对应以下表中的恒流值。

| OUTR | R14   | R13   | R12   | R11   | R10   | 数值 | 恒流值 (mA) |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----------|
|      | BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 |    |          |
| OUTG | G14   | G13   | G12   | G11   | G10   | 数值 | 恒流值 (mA) |
|      | BIT10 | BIT9  | BIT8  | BIT7  | BIT6  |    |          |
| OUTB | B14   | B13   | B12   | B11   | B10   | 数值 | 恒流值 (mA) |
|      | BIT5  | BIT4  | BIT3  | BIT2  | BIT1  |    |          |
|      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 10       |
|      | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1  | 11       |
|      | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2  | 12       |
|      | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 3  | 13       |
|      | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 4  | 14       |
|      | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 5  | 15       |
|      | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 6  | 16       |
|      | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 7  | 17       |
|      | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 8  | 18       |
|      | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 9  | 19       |
|      | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 10 | 20       |
|      | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 11 | 21       |
|      | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 12 | 22       |
|      | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 13 | 23       |
|      | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 14 | 24       |
|      | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 15 | 25       |
|      | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 16 | 26       |
|      | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 17 | 27       |
|      | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 18 | 28       |
|      | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 19 | 29       |
|      | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 20 | 30       |
|      | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 21 | 31       |
|      | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 22 | 32       |
|      | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 23 | 33       |
|      | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 24 | 34       |
|      | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 25 | 35       |
|      | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 26 | 36       |
|      | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 27 | 37       |
|      | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 28 | 38       |
|      | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 29 | 39       |
|      | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 30 | 40       |
|      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 31 | 41       |

PWM模式命令：

如果24bit数据包中，高8位不全为1，该数据包是PWM设定数据，其结构如下：



PWM占空比从0-255连续可调，注意高8位不全为1。

24bit数据发送时高位先发，按照RGB的顺序发送数据。24位可拆分成3个8位数据来发送，注意字节与字节之间的高电平时间不要超过RESET信号时间，否则芯片会复位，复位后又重新接收数据，则无法实现数据传输。

#### 低速模式时间

| 符号     | 参数           | 测试条件             | 最小值  | 典型值 | 最大值  | 单位 |
|--------|--------------|------------------|------|-----|------|----|
| T0l    | 输入0码，低电平时间   | VDD=5V<br>GND=0V | 150  | 300 | 450  | ns |
| T1l    | 输入1码，低电平时间   |                  | 600  | 800 | 1000 | ns |
| T0l'   | 输出0码，低电平时间   |                  | --   | 340 | --   | ns |
| T1l'   | 输出1码，低电平时间   |                  | --   | 680 | --   | ns |
| T      | 0码或1码的周期时间   |                  | 1200 |     | --   | ns |
| Treset | Reset码，高电平时间 |                  | 140  | 500 |      | μs |

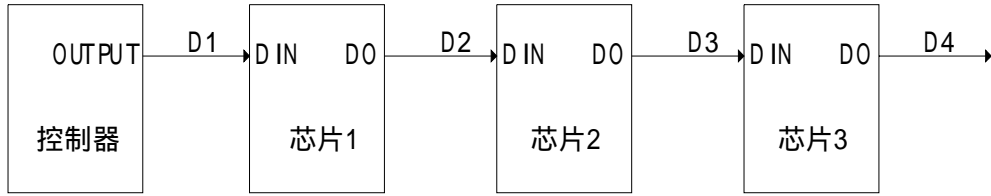
**注意：**低速模式下发送1码或0码的周期时间为1200ns（频率800KHZ）。

#### 高速模式时间

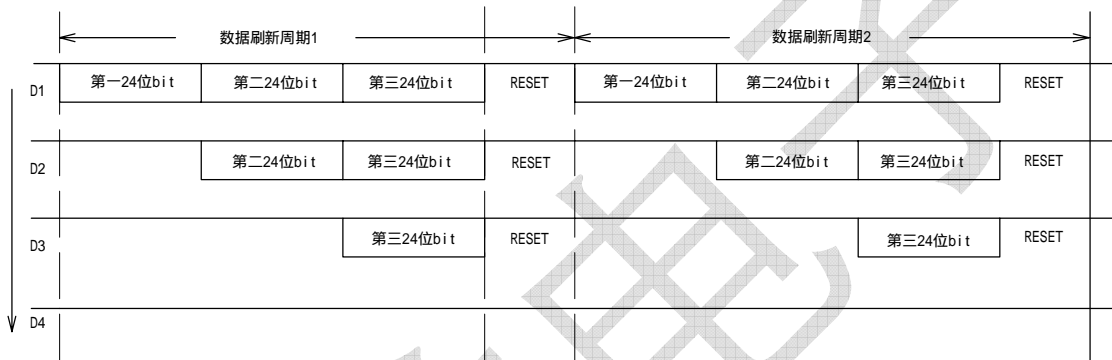
| 符号     | 参数           | 测试条件             | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------|--------------|------------------|-----|-----|-----|----|
| T0l    | 输入0码，低电平时间   | VDD=5V<br>GND=0V | 50  | 170 | 250 | ns |
| T1l    | 输入1码，低电平时间   |                  | 300 | 450 | 550 | ns |
| T0l'   | 输出0码，低电平时间   |                  | --  | 170 | --  | ns |
| T1l'   | 输出1码，低电平时间   |                  | --  | 340 | --  | ns |
| T      | 0码或1码的周期时间   |                  | 600 |     | --  | ns |
| Treset | Reset码，高电平时间 |                  | 140 | 500 |     | μs |

**注意：**高速模式下发送1码或0码的周期时间为600ns（频率1.6MHZ）。高低速模式的Treset复位时间是一样的。

**2、数据传输和转发**



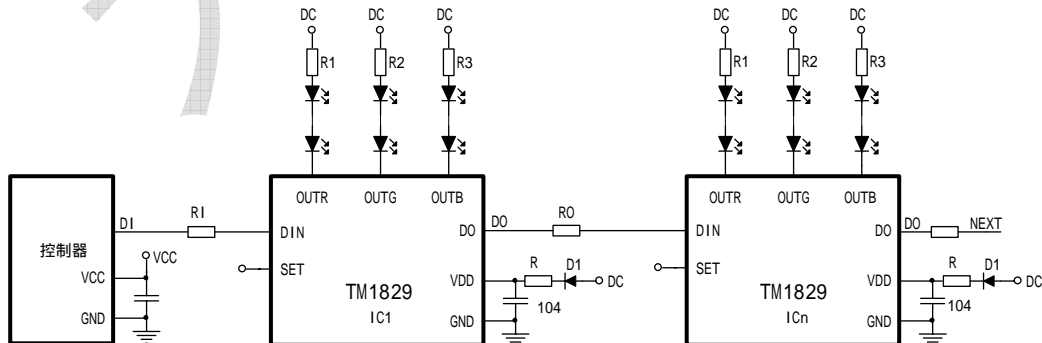
其中D1为控制器发送的数据，D2、D3、D4为级联TM1829转发的数据



芯片级联和数据传输并转发过程：控制器发来数据（D1），当芯片1接收完第一24bit，芯片1还没有转发数据（D2），接着控制器继续发来数据，芯片1再接收第二24bit，由于芯片1已经存有了第一24bit，因此，芯片1通过D0把第二24bit转发出去，芯片2接收芯片1转发来的数据（D2），此时，芯片2还没有转发数据（D3）；控制器继续发来数据，芯片1又把接收到的第三24bit转发到芯片2，由于芯片2也已经存有一个24bit，所以，芯片2又把第三24bit转发（D3），芯片3接收到第三24bit，此时如果控制器发送一个RESET高电平信号，所有芯片就会复位并把各自接收到的24bit数据解码后控制RGB端口输出，完成一个数据刷新周期。芯片又回到接收准备状态。

**应用信息**

**1、典型应用电路**





## 2、电源配置

TM1829 可以配置成 DC6 ~ 24V 电压供电，但根据输入电压不同，应配置不同的电源电阻，电阻计算方法：由于在实际应用中，电源电压会随着负载的增大而降低。所以设置流过 VDD 脚的电流按 4.5mA 计算，所以串接 VDD 的电阻  $R = (DC - 5.0V) / 4.5mA$  (DC 为电源电压)。

配置电阻典型值列表如下：

| 电源电压 DC | 建议电源接口与 VDD 间连接电阻值 |
|---------|--------------------|
| 5V      | 无需接电阻，内部稳压管不起作用    |
| 6V      | 100                |
| 9V      | 750                |
| 12V     | 1.5K               |
| 24V     | 3.9K               |

SET 端接高电平时，应连接在 VDD，禁止接外部电源 VCC，防止芯片击穿。建议在电源输入端接防反接二极管来保护芯片。

## 3、如何计算数据刷新速率

数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的，一组 RGB 通常为一个像素，需要一个 TM1829 芯片来控制。

按照高速模式计算：

一 BIT 传输最高速率为 600ns (频率 1.6MHz)，一个像素数据包括红 (8BIT)，绿 (8BIT)，蓝 (8BIT) 共 24BIT 位，传输时间为  $24 \times 0.6 \mu S = 14.4 \mu S$ ，如果一个系统中共有 2000 个像素点，一次刷新全部显示的时间为  $14.4 \mu S \times 2000 = 28.8mS$  (忽略 RESET 码时间)，即一秒钟刷新率为： $1 \div 28.8 \times 1000 = 34.7Hz$ 。

低速模式刷新速率对应高速模式下减一倍。

以下是级联点阵数对应最高数据刷新率表格：

| 像素点    | 高速模式            |            | 低速模式            |            |
|--------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|        | 最快一次刷新数据时间 (mS) | 最高刷新率 (Hz) | 最快一次刷新数据时间 (mS) | 最高刷新率 (Hz) |
| 1~500  | 7.2             | 138        | 14.4            | 69         |
| 1~800  | 11.52           | 87         | 23.04           | 44         |
| 1~1000 | 14.4            | 69         | 28.8            | 35         |
| 1~1500 | 21.6            | 46         | 43.2            | 23         |
| 1~1800 | 25.92           | 38         | 51.84           | 19         |
| 1~2000 | 28.8            | 35         | 57.6            | 17         |

如果系统对数据刷新率要求不高，则对级联像素点阵数量无要求，只要供电正常，理论上可用 TM1829 无限级联。

## 4、如何使 TM1829 工作在最佳恒流状态

TM1829 输出为恒流驱动，输出时根据恒流曲线可知，在恒流 41mA 电流时，进入恒流区域 OUT 端电压需为 1.2V 以上，这时芯片才有恒流效果，但并非此 OUT 端电压越高越好，电压越高，降在芯片上功耗越大，芯片发热严重，降低整个系统可靠性，因此建议 OUT 端开启时电压  $V_{out}$  控制在 1.2~3V 之间较好，常用串联电阻方式进行使用，以下是选用电阻理论计算方式：

系统驱动电压：VDD

单个 LED 导通压降： $V_{led}$

串联 LED 个数： $n$

恒流值： $I_{out}$

恒流电压：1.5V

电阻：R

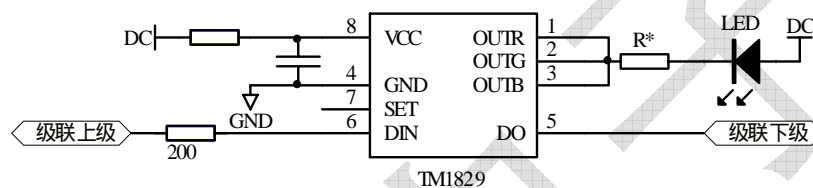
$$R = (VDD - 1.5 - n \times V_{led}) / I_{out}$$

例：系统供电24V，单个LED导通压降：2V，串联LED个数：6个，恒流值40mA

应串联电阻： $R = (24 - 1.5 - 2 \times 6) / 0.04 = 262.5$ ，只需在OUT引脚上串联260 左右的电阻即可

### 5、使用TM1829如何扩流

TM1829每个OUT端最大只能输出41mA恒流，如果用户需要扩大恒流值驱动，可将其中三个OUT端短接后使用，每短路一个OUT端，恒流值最大和将增加41mA，三路短接后最高可恒流123mA左右，但是此方法缺点是需软件同时配合控制，分别写三组寄存器值，优点是可精确得到想要的电流值和恒流电流较大。



### 6、用程序驱动LED方法

5.1 要实现芯片对LED亮度控制，首先确保RGB端口电压，能够使芯片进入恒流工作（具体参考“恒流曲线”）；

5.2 芯片上电复位，初始化先对恒流值进行设定且测试模式位T为0（允许PWM输出），如设定输出通道RGB的恒流电流为20mA，那么允许流过最大电流就为20mA。应根据LED设定恒流值；

5.3 对PWM寄存器进行写入，设定PWM输出，如设定输出通道RGB的PWM辉度级别为100，那么流过LED的电流为 $100 \div 256 \times 20\text{mA} = 7.8\text{mA}$ ；

5.4 不停改变PWM的值，就能随心所欲调节LED亮度了。设定PWM值为0，输出全高，LED灭。设定PWM值为FFH（注意24BIT高8位不能全为1），输出最大低电平占空比波形，LED最亮。

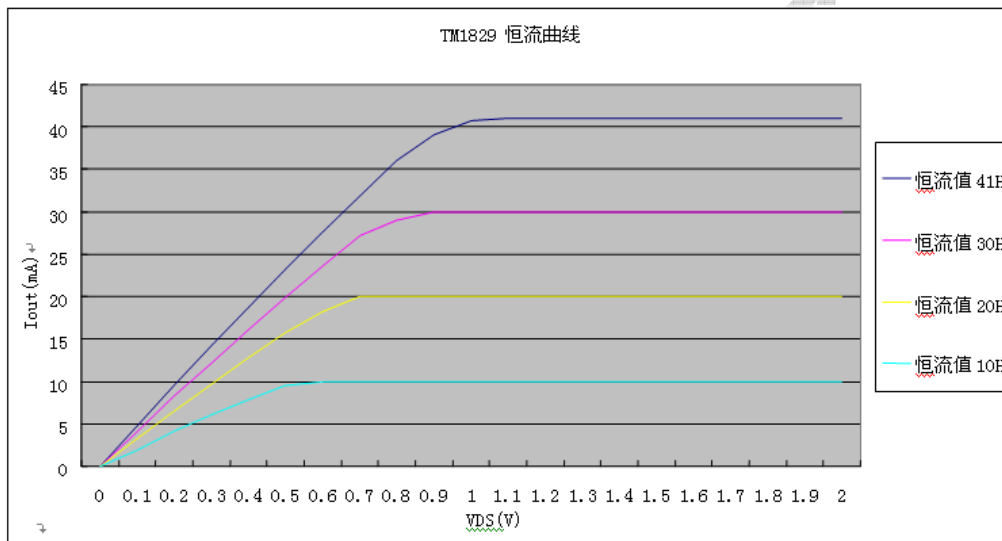
5.5 如果设定恒流值且测试模式位T为1，则进入测试模式。

**注意事项：**为避免芯片断电后又上电而控制器没有断电，造成初始化设定的恒流寄存器值丢失，恒流电流改变，建议在刷新PWM寄存器的过程中定时刷新恒流寄存器或者刷新一次恒流寄存器再刷新一次PWM寄存器。

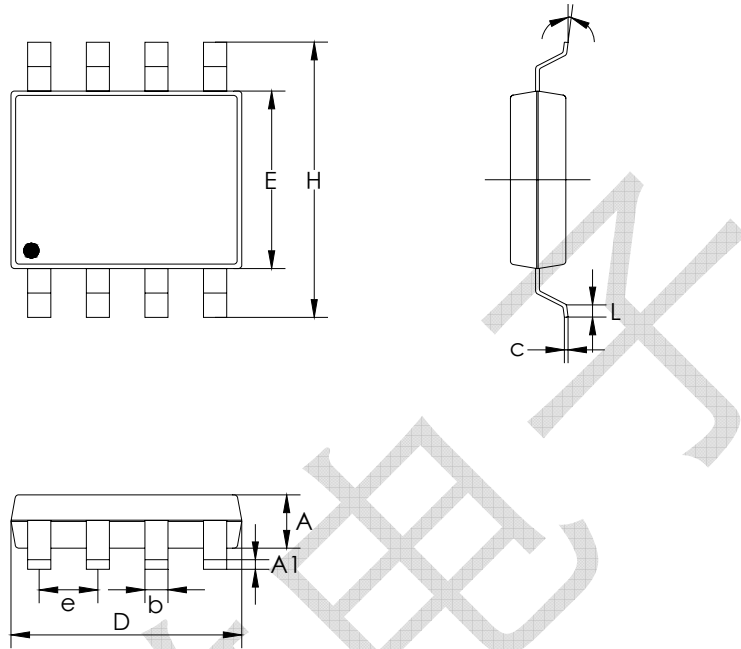
### 恒流曲线

将 TM1829 应用到 LED 面板设计上时，通道间甚至芯片间的电流差异极小。此源于 TM1829 的优异特性：

- 当负载端电压发生变化时，其输出电流的稳定性不受影响，如下图所示
- 图中所示，输出端口的电流  $I_{out}$  与加在端口上的电压  $V_{ds}$  关系可知，当在恒流工作状态下，端口输出  $I_{out}$  为恒流值， $I_{out}$  恒流电流越小，需要的  $V_{ds}$  也越小，最小不能小于 0.8V。

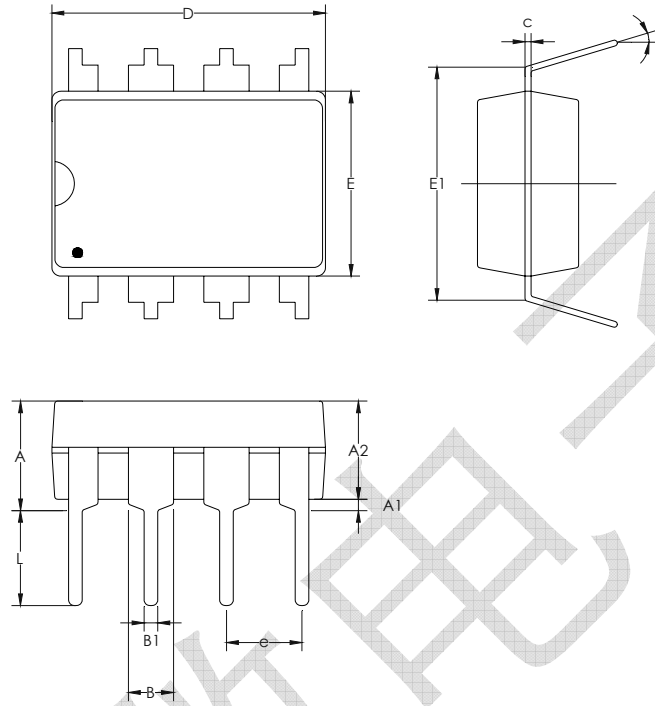


封装示意图 (SOP8)



| 标号 | 英寸    |       |       | 毫米   |      |      |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|
|    | 最小    | 标准    | 最大    | 最小   | 标准   | 最大   |
| A  | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 1.30 | 1.50 | 1.70 |
| A1 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.06 | 0.16 | 0.26 |
| b  | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.30 | 0.40 | 0.55 |
| c  | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
| D  | 0.186 | 0.194 | 0.202 | 4.72 | 4.92 | 5.12 |
| E  | 0.148 | 0.156 | 0.163 | 3.75 | 3.95 | 4.15 |
| e  |       | 0.050 |       |      | 1.27 |      |
| H  | 0.224 | 0.236 | 0.248 | 5.70 | 6.00 | 6.30 |
| L  | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.45 | 0.65 | 0.85 |
|    | 0°    |       | 8°    | 0°   |      | 8°   |

封装示意图 (DIP8)



| 标号 | 英寸    |       |       | 毫米   |      |      |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|
|    | 最小    | 标准    | 最大    | 最小   | 标准   | 最大   |
| A  |       |       | 0.170 |      |      | 4.31 |
| A1 | 0.015 |       |       | 0.38 |      |      |
| A2 | 0.124 | 0.134 | 0.144 | 3.15 | 3.4  | 3.65 |
| B  | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.38 | 0.46 | 0.51 |
| B1 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 1.27 | 1.52 | 1.77 |
| c  | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| D  | 0.352 | 0.362 | 0.372 | 8.95 | 9.20 | 9.45 |
| E  | 0.242 | 0.252 | 0.262 | 6.15 | 6.40 | 6.65 |
| E1 |       | 0.300 |       |      | 7.62 |      |
| e  |       | 0.100 |       |      | 2.54 |      |
| L  | 0.118 | 0.130 | 0.142 | 3.00 | 3.30 | 3.60 |
|    | 0°    |       | 15°   | 0°   |      | 15°  |

All specs and applications shown above subject to change without prior notice.  
(以上电路及规格仅供参考, 如本公司进行修正, 恕不另行通知)

修订历史

| 版本   | 发行日期       | 修订简介 |
|------|------------|------|
| V1.0 | 2011-12-21 | 正式版  |
| V1.1 | 2012-02-22 | 修订版  |
| V1.2 | 2012-05-08 | 改版发行 |
| V1.3 | 2012-06-21 | 改版发行 |
| V1.4 | 2013-01-04 | 改版发行 |

天微电子